

证券代码：600641

证券简称：万业企业

## 上海万业企业股份有限公司

### 2023 年半年度业绩说明会会议纪要

<b>投资者关系活动类别</b>	业绩说明会
<b>参与对象</b>	投资者
<b>时间</b>	2023 年 10 月 9 日上午 9:00-10:00
<b>地点</b>	上证路演中心
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事、总经理：王晓波先生 董事：刘荣明先生 独立董事：万华林先生 副总经理：江加如先生 财务总监：邵伟宏先生 副总经理、董事会秘书：周伟芳女士
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>公司情况介绍：</p> <p>万业企业是一家专注于半导体集成电路设备材料领域的高科技企业。近年来，我们通过“外延并购+产业整合”的双轮驱动，陆续收购凯世通、Compart Systems，成立嘉芯半导体，持续加大集成电路在公司整体业务中的比重。2023 年上半年，公司实现营收 3.89 亿元，同比增长 134.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比增长 318.10%。上半年研发费用达到 5380.91 万元，同比增长 109.20%。</p> <p>从营收结构来看，2023 年上半年公司集成电路营收达到 1.03 亿元，约占总营收的 26%。从订单表现方面，2023 年上半年公司旗下两大集成电路控股子公司凯世通和嘉芯半导体在本土主流晶圆厂国产线采购中均有所收获，累计获得集成电路设备订单近 3 亿元，其中凯世通约 1.6 亿元，嘉芯半导体约 1.3 亿元。两家公司累计集成电路设备订单金额近 15 亿元。此外，从产品矩阵来看，万业企业已叠加形成多个半导体前道核心设备产品线，业务覆盖离子注入机、刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多个核心品类。</p>

首先，公司旗下凯世通半导体是国内领先的集成电路离子注入机供应商，涵盖逻辑、存储、功率等多个应用领域方向，自2020年起已与多家12英寸集成电路制造厂主流客户签署了采购订单，累计金额超10亿元。2023年起，凯世通设备在重点晶圆厂客户的量产产线上综合表现持续提升，并新增2家重要的晶圆厂新客户，新增订单金额超1.6亿元。随着今年5月，凯世通位于上海浦东金桥的新研发制造基地正式启用，将增强其关键装备离子注入机研发与产业化能力，进一步提升凯世通研发、客服、产能保障等全方位能力，助力国产高端集成电路装备高质量发展。

其次，公司和国际顶级技术团队联合创办的嘉芯半导体公司进一步夯实半导体设备平台化发展，以多品类设备叠加原有的离子注入机业务形成“1+N”产品平台模式。2023年至今，嘉芯半导体新增订单金额超1.3亿元，成立后累计获取订单金额突破4.7亿元，已形成多个半导体前道核心设备产品线，业务覆盖刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多类主制程设备以及尾气处理等支撑制程设备。同时，嘉芯半导体集成电路设备研发制造基地将于10月中旬全部竣工，预计11月项目投产，届时将以109亩土地14万方的厂房面积加速推动长三角一体化发展示范区核心设备基地的建设落成。嘉芯半导体以领先的国际化团队和研发能力致力于为半导体设备国产化添砖加瓦，将逐渐形成极具特色的半导体核心设备产业集群。

在发展战略上，为了更好地推进半导体设备业务的发展，公司将继续“外延并购+产业整合”，同时加大对技术研发的投入和专业人才的吸纳引进，以构建半导体核心设备领域的全面竞争力。未来，万业企业将锚定聚焦半导体设备业务领域，完善产业链布局，并通过“1+N”设备平台化战略的实施，持续推动协同效应的释放，致力于成为中国集成电路产业链打造最完整的装备材料平台公司之一。

主要交流问答：

Q：请问公司今年上半年的营收结构是怎么样的？

A: 尊敬的投资者,您好。近年来,万业聚焦半导体集成电路设备领域业务板块并持续深耕发力,上半年公司实现营收 3.89 亿元,同比增长 134.34%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元,同比增长 318.10%。上半年研发费用达到 5380.91 万元,同比增长 109.20%。从营收结构来看,2023 年上半年公司集成电路营收实现增长,为 1.03 亿元,约占总营收的 26%。感谢您的关注。

Q: 请董秘介绍一下今年上半年的经营概况?

A: 尊敬的投资者,您好。2023 上半年,公司专注于半导体集成电路设备领域持续深耕,聚焦力量推动向集成电路产业领域转型,坚持以高研发投入驱动技术升级,将已有实现产业化的领域如离子注入、刻蚀以及薄膜沉积等多品类设备做精做深,持续拓展市场及下游半导体客户资源,形成独具竞争优势的产品系列,同时持续强化公司运营管理,促进公司持续、稳健、快速的发展,在经营业绩、市场销售等方面取得了进展。公司在上半年实现营业收入 3.89 亿元,同比增长 134.34%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元,同比增长 318.10%;扣除非经常性损益后,实现归属于上市公司股东的净利润 0.25 亿元,同比增加 1.03%。感谢您的关注。

Q: 请问上半年嘉芯半导体的营业收入是多少?

A: 尊敬的投资者,您好。公司旗下子公司嘉芯半导体 2023 年上半年营业收入为 6510.48 万元,同比增长 633.71%。感谢您的关注。

Q: 请领导介绍一下公司上半年研发情况和变动原因?

A: 尊敬的投资者,您好。为了不断实现半导体设备工艺突破,万业企业始终以研发创新为公司长期持续发展的第一动力,2023 年上半年,公司研发费用达 5381 万元,同比增长 109.20%,通过持续加大研发投入,不断开发满足、引导市场需求的自研前沿技术及产品。研发大幅增长的原因主要由于公司控股子公司凯世通研发投入较上年同期增加

所致。近年来，公司始终保持大额的研发投入和较高的研发投入占比。未来公司将坚持高强度的研发投入，持续迭代升级、优化现有设备和工艺，力求不断推出面向未来发展需求的新工艺、新设备。感谢您的关注。

Q: 请问公司目前的存货情况？

A: 尊敬的投资者，您好。2023年起截至半年报发布日，公司存货为11.92亿元，较年初增加32.34%。主要是由于子公司凯世通和嘉芯半导体零部件备货和生产产品投入增加所致。感谢您的关注。

Q: 请问各位领导嘉芯半导体的新厂房什么时候能落地投产？

A: 尊敬的投资者，您好。为更好地完善公司的产业链布局，进一步推动长三角一体化发展示范区核心设备基地的建设落成，嘉芯半导体于2021年年底竞得嘉善县109亩的国有建设用地使用权，用于打造种类齐全的设备研发及制造基地。目前新厂房建设项目将于2023年10月中旬全部竣工，预计2023年10月底项目投产。嘉芯半导体以领先的国际化团队和研发能力助力半导体设备国产化，将逐渐形成极具特色的半导体核心设备产业集群。感谢您的关注。

Q: 公司旗下的嘉芯半导体的研发模式是怎么样的？

A: 尊敬的投资者，您好。作为万业企业的成熟制程设备平台，嘉芯半导体由公司和重要专家联合创办，汇聚一批国内外成熟技术团队，以多品类设备叠加原有的离子注入机业务形成“1+N”产品平台模式。通过专注技术研发，为嘉芯半导体构建深厚的竞争护城河，其自研的PVD设备PHOEBUS是一种全自动集群式PVD（物理气相沉积），可容纳多个沉积室的系统，能够精确控制过程，进行高水平通过创造超高真空（ $10E-8\text{torr}$ ）的环境并控制各种变量过程，采用真空溅射薄膜沉积工艺。其主流的工艺腔体对接设计，可以增加客户选择的灵活性，根据工艺需求来选择不同配置的腔体。目前针对化学气相薄膜沉积设备，

嘉芯半导体还进行新产品及新工艺的开发立项，主要应用于成熟工艺的半导体前段薄膜沉积工艺应用。在专注研发道路上，嘉芯半导体步履不停，2023年8月，嘉芯半导体与嘉善复旦研究院顺利完成战略合作签约仪式，双方将携手加强科研投入与人才建设，实现产-学-研融合，加快高质量发展步伐。感谢您的关注。

Q:公司控股公司凯世通主要发展方向是什么，请领导详细介绍一下？

A:尊敬的投资者，您好。公司旗下控股子公司凯世通致力于集成电路离子注入设备的自主研发和创新，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，解决了高端芯片实际生产过程中面临的极低能量大剂量注入、高角度均匀性、颗粒污染控制、低能量注入能量污染、设备高产能等技术挑战。核心技术包括大束流离子源、离子束光学系统、低能减速装置、高真空高精度离子注入平台等，能够满足不同应用芯片产线的工艺与良率要求，并可不断提升客户产线产能，降低单位生产成本。基于“通用平台+模块化”开发模式，公司开发了低能大束流、高能离子注入机系列产品，其稳定性、可靠性通过了国内多家晶圆厂客户验证验收及商业化订单，并在不断积累经验曲线。感谢您的关注。

Q:请公司介绍一下凯世通的主要产品和销售模式？

A:尊敬的投资者，您好。凯世通所涉核心装备业务是以离子束技术为核心的集研发、制造于一体的高科技项目，主要业务是研发、生产、销售国际领先的高端离子注入机，重点应用于半导体集成电路等领域。销售模式以直销为主，销售部负责市场分析和开拓、线索整理、潜在客户分析跟踪、客户接洽等工作。同时，公司先通过行业展会、业内交流、政府或相关机构引荐，以及客户推荐等方式收集潜在客户信息。其次经过技术需求沟通和商务谈判后，双方签订销售合同或产品试用合同。再次按照合同约定，将产品发送至客户，经安装、调试、验收后，确认销售收入。目前营业收入构成包括自研离子注入机、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业务等。感谢您的关注。

Q:能否请公司领导介绍一下凯世通的专利情况？

A: 尊敬的投资者，您好。凯世通持续并加强知识产权体系建设，建立了涵盖整机系统、关键技术和工艺应用的全方位专利体系，拥有多项自主知识产权和核心技术。截至 2023 年 6 月 30 日，凯世通已获授权专利 139 项，其中发明专利 83 项，并获得“中国半导体领域高质量引领企业”荣誉称号和“上海市企业技术中心”认定。感谢您的关注。

Q:今年上半年凯世通启用了新的制造基地，请领导详细说一下该基地详细情况？

A: 尊敬的投资者，您好。今年 5 月凯世通正式启用上海浦东金桥研发制造基地，增强了离子注入机系列产品的研发与产业化能力，提升了其自身的研发实力、客服水平、产能保障等综合竞争力。作为新落成的产业化中心，凯世通金桥基地无尘车间与办公总面积超过 4,400 平米，涵盖了技术研发、CIP 改进、零部件组装与验证、工艺验证、生产制造、客户培训等功能，并可向客户及合作伙伴提供低能大束流、超低温低能大束流、重金属低能大束流、高能离子注入机等全系列产品评估，缩短从技术验证到客户导入的时间。感谢您的关注。

Q:能否请周总介绍一下目前万业企业的产品矩阵情况，谢谢。

A:尊敬的投资者，您好。公司的设备产品现已覆盖集成电路离子注入机、刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多款集成电路核心前道设备以及尾气处理等支撑制程设备。同时，嘉芯半导体集成电路设备研发制造基地将以 109 亩土地 14 万方的新产能面积加速推动长三角一体化发展示范区核心设备基地的建设落成，进一步丰富公司“1+N”半导体设备产品平台矩阵。

除了现有布局的半导体设备平台矩阵外，浦科投资作为公司控股股东，在新兴产业领域有着多年成功投资经验，有利于公司向新兴产业、高附加值产业领域转型。特别是与上海半导体装备材料基金的密切配合，

不仅有助于加快公司自身转型步伐，也有望在未来扩宽公司集成电路产业的延伸发展。

Q:今年房地产市场环境不好，公司还有一些房地产业务，现在是怎么规划的？

A:尊敬的投资者，您好。公司自2015年起不再有新增土储，同时切实做好现有存量房产的开发、销售工作，为公司转型提供有力保障。面对经济下行及市场低迷徘徊的压力，因地制宜，灵活应对，注重实效，发挥自身优势，借助创新营销手段和丰富渠道资源，实现销售目标。公司将发挥原有房地产的开发资源，与集成电路核心装备业务做好融合，强化转型协同和叠加效应。感谢您的关注。

Q：目前公司上半年房地产业务经营情况和存量情况如何？

A：尊敬的投资者，您好。2023年上半年，公司启动宝山B2住宅项目及无锡地下车位销售。其中，无锡地下车位截至2023年6月30日已基本完成全年度销售目标；宝山B2项目启动销售蓄客后，在职能部门和项目公司通力合作下，该项目于第二批次即获得了上市许可，开盘销售并实现售罄，同时加快资金回笼及现房交付工作，实现部分房源交付收入结转。2023年上半年，公司共计实现签约金额51,934万元（含税），其中签约住宅金额约47,704万元（含税），签约住宅面积9,875平方米；实现结转收入金额25,092万元，其中住宅结转收入金额21,849万元，住宅结转面积4,798平方米。具体相关信息请投资者以公司公告信息为准，感谢您的关注。

Q:公司目前在转型并且账上现金充足，未来会考虑投资其他项目吗？

A:尊敬的投资者，您好。近年来，万业企业凭借自主研发和外延式并购的双重驱动，不断推动公司向集成电路产业领域快速迈进。基于自身战略和长远发展考虑，公司将根据具体情况进行投资决策，以寻求更多的合适项目。具体请以公司后续披露的公告为准。感谢您的关注。

Q:请问公司关于更名有何新进度吗,大概什么时候能完成更名?

A:尊敬的投资者,您好。根据相关监管部门要求,公司主营业务收入达一定比例后才可变更名称。其他相关情况请以公司披露的定期报告及公告为准。感谢您的关注。

Q:近年来随着外部环境的变化,公司如何看待目前国内的集成电路设备行业发展趋势?

A:尊敬的投资者,您好。当前,外部环境的变化为我国半导体设备行业带来了挑战,同时也孕育着前所未有的机遇,有助于推动半导体设备国产化率的提升。在当前国际和国内市场现状以及技术发展趋势下,半导体设备核心技术的独立性和自主可控性显得愈发重要。近年来,我国半导体产业链不断完善,国内半导体设备制造业技术水平不断提高,本土化半导体设备市场空间巨大。此外,先进封装 Chiplet 能有效提升集成度并保证良率,是后摩尔时代我国芯片弯道超车的重要途径。通过成熟制程产品进行 2.5/3D 堆叠以实现高性能芯片效果。而目前我国成熟工艺设备国产化率仍偏低,后续将进一步扩大对国产成熟制程设备的需求。公司将以期实现上下游行业的协同发展,共享共赢的愿景目标。感谢您的关注。

Q:公司将会通过什么方式,哪些措施来实现发展战略目标,请领导详细介绍?

A:尊敬的投资者,您好。公司始终坚持“外延并购+产业整合”的发展策略,向集成电路设备领域坚定推进战略转型。同时,随着集成电路业务进入放量增长阶段,公司对总部内部管理机构进行了重新规划定位,具体包括增设“集成电路产业研究发展中心”、改设“集成电路产业经营中心”和“集成电路产业服务中心”等内部管理机构,以及设立“集成电路专家委员会”,吸纳行业专家为集成电路业务发展、经营及重要决策提供建议,从而为公司深化转型提供支持和保障。此

外，加大对技术研发的投入和专业技术、管理人才的吸纳引进，以加强公司在集成电路核心设备领域的全面竞争力。感谢您的关注。

Q: 请问公司之前参股的产业基金上半年有什么新进展吗？

A: 尊敬的投资者，您好。公司于 2017 年参股的装备材料一期项目有序推进中。此外公司于 2023 年参股投资的上海半导体装备材料产业投资基金二期经工商核准后，正式命名为“上海半导体装备材料二期私募投资基金”，2023 年 5 月基金参与各方正式签署合作协议，2023 年 6 月完成中国证券投资基金业协会备案。公司将进一步巩固产业链协同效应，完善公司集成电路业务布局。感谢您的关注。

Q: 作为业务转型企业，公司未来的发展战略是什么？

A: 尊敬的投资者，您好。公司未来将持续战略布局半导体设备材料赛道，通过“外延并购+产业整合”双轮驱动，持续打造“1+N”的平台模式，即在已有实现产业化的领域如离子注入、刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多类设备做精做深，同时根据市场动态和客户需求，利用现金储备优势，围绕集成电路制造工艺拓展业务品类，在完善工艺链条的同时努力实现上下游产业链协同，推动平台产品矩阵的进一步完善及产业稳步延伸发展，力求带来订单和收入利润的新突破。感谢您的关注。

Q: 公司布局集成电路领域需要强大的研发做支撑，请问公司目前的研发团队有什么研发技术优势吗？

A: 尊敬的投资者，您好。公司已经打造了一支高端人才引领的有梯队、有层次的技术和管理团队，并引进多个国内外资深半导体技术与运营管理专家团队落地国内。今年，我们聘请了在集成电路芯片和设备制造领域拥有丰富行业经验和投资经验的技术及管理专家王晓波先生担任公司总裁，为公司战略发展注入新动能。近年来，公司立足核心技术研发，积极为旗下子公司引进海外高层次人才的同时，自主培养本

土科研团队，全面构建人才团队。其一子公司的技术团队结构合理，分工明确，专业知识储备深厚，产线验证经验丰富，是奠定公司技术实力的基石；其二子公司研发、工程与应用各职能间深度融合，产品端与市场端无缝衔接，也进一步保障公司产品的市场竞争力。感谢您的关注。

Q: 请问各位领导，公司参与装备材料二期基金的深层次意义是什么，对后续企业的经营发展有何影响？

A: 尊敬的投资者，您好。当前，万业企业正处于关键的转型时期。经过我们不遗余力的努力，房地产业务的占比将大幅度下降，而公司对半导体板块的提升将日益增强。我们正在尽快提高半导体业务的收入和盈利能力。为了强化万业企业的半导体业务，我们会通过联合投资、协同并购、促进整合等方式进行积极布局。参与装备材料二期基金，亦是万业企业转型的关键一步。

首先，参与二期基金将有助于万业企业加快转型步伐。二期基金对接国家和上海集成电路产业发展的总体战略，专注于半导体装备材料及核心零配件的投资布局，重点关注国家和上海重点支持、且亟需突破的关键技术领域。通过参与二期基金，将帮助公司直接对接上海市和国家的战略布局，提升万业企业转型的高度。

其次，依托于二期基金，万业企业可以更广泛地接触境内外集成电路产业上下游资源。我们始终致力于通过“外延并购+产业整合”的方式，积极寻找集成电路装备与材料的上下游并购项目。感谢您的关注。

Q: 请简单介绍一下公司在客户服务的核心优势？

A: 尊敬的投资者，您好。公司紧贴客户需求，从“第一性原理”出发，针对不同客户产品对工艺、应用提出的差异化技术需求进行产品、服务定制，快速迭代升级，由此与客户形成了紧密的合作关系。随着设备国产化进程不断加快，相较于国际竞争对手，公司旗下凯世通和嘉芯半导体在全国有多处驻点，在地域上更贴近客户，能够提供高效、

	<p>及时的技术支持和客户服务。与此同时，公司部分设备产品在龙头企业晶圆厂产线的综合性能表现不断提升，以及公司专业的售后服务能力均为公司在业内树立了良好的品牌形象，成为了客户国产设备供应商中的样板。凯世通将秉持“没有最好，只有更好”的CIP理念，落实“三个持续”，以客户满意为目标，用自身的高端离子注入机系列产品的产业化实践经验助力芯片制造厂商量产与提升。感谢您的关注。</p>
--	---